

# 2020年中国半导体封装产业分析报告- 行业深度分析与投资前景预测

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国半导体封装产业分析报告-行业深度分析与投资前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/516238516238.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

半导体封装测试是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程，是半导体产业链的最后一个环节。半导体封测包括封装和测试两个环节，封装是保护芯片免受损伤，增强芯片的散热性能，实现电气连接，确保电路正常工作；测试主要是对芯片产品的功能、性能测试等，将功能、性能不符合要求的产品筛选出来。

半导体封装和测试主要功能

阶段

功能

简介

封装

电力传送

电子产品电力之间传送必须经过线路大的连接方式可达成，可稳定地驱动IC

信号传送

外界输入的信号，需透过封装层线路以送达正确的位置

散热功能

将传递所产生的热量去除，使IC芯片不致因过热而毁损

保护功能

避免受到外部环境污染的可能性

测试

晶圆测试

测试晶圆电性

成品测试

测试IC功能、电性与散热是否正常资料来源：公开资料

随着半导体技术创新发展，尤其是高端封装产品的需求不断提升，封测行业持续进步。当前，全球封装行业的主流处于以第三阶段的CSP、BGA为主要封装形式，并向第四、第五阶段的SiP、SoC、TSV等先进封装形式迈进。

半导体封装技术发展阶段

阶段

时间

封装形式

第一阶段

20世纪70年代以前

通孔装型封装

第二阶段

20世纪80年代以后

表面贴装型封装

第三阶段

20世纪90年代以后

球栅阵列封装（BGA）

晶圆级封装（WLP）

芯片级封装（CSP）

第四阶段

20世纪末开始

多芯片组装（MCM）

系统级封装（SiP）

三维立体封装（3D）

芯片上制作凸点（Bumping）

第五阶段

21世纪前10年开始

系统级单芯片封装（SoC）

微电子机械系统封装（MEMS）

晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）

倒装焊封装（FC）

表面活化室温连接（SAB）

扇外型集成电路封装（Fan-Out）资料来源：公开资料

随着全球半导体行业市场规模的增长，以及国际代工模式的兴起，我国封测行业迎来了良好的发展机遇。封测环节相对于其他环节而言对资金和技术的要求相对较低，我国封测业有望率先实现国产替代。中国大陆封测市场份额逐步扩大，已经从2016年的14%提升至2019年的28%，影响力日益凸显。

2016-2019年我国封测企业全球份额变化情况 资料来源：公开资料

2019年全球封测市场中，中国台湾以53.9%的市场份额占据半壁江山，中国大陆市场份额为28.1%，美国市场份额为18.1%。

2019年全球封测市场占比 资料来源：公开资料

我国半导体封测行业整体上与半导体行业一起成长起来，并且过去是我国半导体行业四大推动力中最高的一块。但是在2012年以后，封装测试业成长弱于整个集成电路产业，并且封装测试行业在半导体整体行业中的比例下降。2019年我国半导体封测行业营业收入为2349.7亿元，同比增长7.1%。

2015-2019年国内半导体封测行业营业收入 资料来源：公开资料

国内封装测试企业分布格局基本没有改变，仍集中在长江三角洲地区，2019年该区域

拥有封测代工企业数量共72家，占比为61%。

2019年国内封测代工企业区域分布 数据来源：公开资料

长电科技自收购星科金朋后，成为中国大陆首家进入封测领域高端市场的玩家，无论是在规模还是技术上都不落后于国际大厂。2020年第二季度，长电科技以845百万美元、13.4%市占率位居全球第四名。

国内封装企业技术分布情况

类别

日月光

安靠

长电科技

矽品

天水华天

通富微电

DTP

×

SOP

×

×

QFP/QFN

×

LGA

×

×

BGA

FC

FCBGA

Bumping

FCCSP

WLCSP

TSV (2.5D)

×

TSV (3D)

×

×

×

×

Fan-out

× (注： 表示：已经实现量产；0表示：正在研发、×表示：未研发) 数据来源：公开资料

2020年第二季度全球十大封测业者营收排名

排名

公司名称

营收 (百万美元)

市占率

营收同比

1

日月光

1379

21.8%

18.9%

2

艾克尔

1173

18.5%

31.1%

3

矽品

910

14.4%

34.2%

4

长电科技

845

13.4%

24.4%

5

力成

649

10.3%

35.6%

6

华天科技

403

6.4%

29.2%

7

通富微电

361

5.7%



28.3%

8

京元电子

256

4%

2.5%

9

南茂科技

182

2.9%

16.6%

10

欣邦科技

168

2.7%

4.8%数据来源：公开资料

自2005年以来中国一直是集成电路最大的消费国，但是中国半导体市场依赖进口。2018年我国逻辑封测产业自给率为41%，存储封测产业自给率仅为9%。随着大批新建晶圆厂产能的释放以及国内主流代工厂产能利用率的提升，加上国内密集出台相关扶持政策，作为我国半导体领域优势最为突出的子行业，国内半导体封测产业自给率有较大提升空间。预计到2024年，我国逻辑封测产业自给率达47%，存储封测产业自给率达22%。

2017-2024年中国半导体封测产业自给率及预测

-

2017

2018

2019E

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

中国逻辑封测产业自给率（%）

39%

41%

41%

42%

43%

44%

45%

47%

中国存储封测产业自给率（%）

10%

9%

10%

12%

14%

16%

22%

22%数据来源：公开资料（TC）

中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国半导体封装产业分析报告-行业深度分析与投资前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的

发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

## 【报告大纲】

### 第一章 2017-2020年中国半导体封装行业发展概述

#### 第一节 半导体封装行业发展情况概述

- 一、半导体封装行业相关定义
- 二、半导体封装行业基本情况介绍
- 三、半导体封装行业发展特点分析

#### 第二节 中国半导体封装行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、半导体封装行业产业链条分析
- 三、中国半导体封装行业上游环节分析
- 四、中国半导体封装行业下游环节分析

#### 第三节 中国半导体封装行业生命周期分析

- 一、半导体封装行业生命周期理论概述
- 二、半导体封装行业所属的生命周期分析

#### 第四节 半导体封装行业经济指标分析

- 一、半导体封装行业的赢利性分析
- 二、半导体封装行业的经济周期分析
- 三、半导体封装行业附加值的提升空间分析

#### 第五节 中国半导体封装行业进入壁垒分析

- 一、半导体封装行业资金壁垒分析
- 二、半导体封装行业技术壁垒分析
- 三、半导体封装行业人才壁垒分析
- 四、半导体封装行业品牌壁垒分析
- 五、半导体封装行业其他壁垒分析

### 第二章 2017-2020年全球半导体封装行业市场发展现状分析

#### 第一节 全球半导体封装行业发展历程回顾

#### 第二节 全球半导体封装行业市场区域分布情况

#### 第三节 亚洲半导体封装行业地区市场分析

- 一、亚洲半导体封装行业市场现状分析
- 二、亚洲半导体封装行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲半导体封装行业市场前景分析

#### 第四节 北美半导体封装行业地区市场分析

- 一、北美半导体封装行业市场现状分析
- 二、北美半导体封装行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美半导体封装行业市场前景分析

#### 第五节 欧盟半导体封装行业地区市场分析

- 一、欧盟半导体封装行业市场现状分析
- 二、欧盟半导体封装行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟半导体封装行业市场前景分析

#### 第六节 2021-2026年世界半导体封装行业分布走势预测

#### 第七节 2021-2026年全球半导体封装行业市场规模预测

### 第三章 中国半导体封装产业发展环境分析

#### 第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品半导体封装总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

#### 第二节 中国半导体封装行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

#### 第三节 中国半导体封装产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

### 第四章 中国半导体封装行业运行情况

#### 第一节 中国半导体封装行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

#### 四、行业发展动态

##### 第二节 中国半导体封装行业市场规模分析

##### 第三节 中国半导体封装行业供应情况分析

##### 第四节 中国半导体封装行业需求情况分析

##### 第五节 中国半导体封装行业供需平衡分析

##### 第六节 中国半导体封装行业发展趋势分析

#### 第五章 中国半导体封装所属行业运行数据监测

##### 第一节 中国半导体封装所属行业总体规模分析

###### 一、企业数量结构分析

###### 二、行业资产规模分析

##### 第二节 中国半导体封装所属行业产销与费用分析

###### 一、流动资产

###### 二、销售收入分析

###### 三、负债分析

###### 四、利润规模分析

###### 五、产值分析

##### 第三节 中国半导体封装所属行业财务指标分析

###### 一、行业盈利能力分析

###### 二、行业偿债能力分析

###### 三、行业营运能力分析

###### 四、行业发展能力分析

#### 第六章 2017-2020年中国半导体封装市场格局分析

##### 第一节 中国半导体封装行业竞争现状分析

###### 一、中国半导体封装行业竞争情况分析

###### 二、中国半导体封装行业主要品牌分析

##### 第二节 中国半导体封装行业集中度分析

###### 一、中国半导体封装行业市场集中度分析

###### 二、中国半导体封装行业企业集中度分析

##### 第三节 中国半导体封装行业存在的问题

##### 第四节 中国半导体封装行业解决问题的策略分析

##### 第五节 中国半导体封装行业竞争力分析

###### 一、生产要素

###### 二、需求条件

### 三、支援与相关产业

### 四、企业战略、结构与竞争状态

### 五、政府的作用

### 第六节 产业结构发展预测

#### 一、产业结构调整指导政策分析

#### 二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

#### 三、中国半导体封装行业参与国际竞争的战略市场定位

#### 四、产业结构调整方向分析

## 第七章 2017-2020年中国半导体封装行业需求特点与动态分析

### 第一节 中国半导体封装行业消费者基本情况

### 第二节 中国半导体封装行业消费者属性及偏好调查

### 第三节 半导体封装行业成本分析

### 第四节 半导体封装行业价格影响因素分析

#### 一、供需因素

#### 二、成本因素

#### 三、其他因素

### 第五节 中国半导体封装行业价格现状分析

### 第六节 中国半导体封装行业平均价格走势预测

#### 一、中国半导体封装行业价格影响因素

#### 二、中国半导体封装行业平均价格走势预测

#### 三、中国半导体封装行业平均价格增速预测

## 第八章 2017-2020年中国半导体封装行业区域市场现状分析

### 第一节 中国半导体封装行业区域市场规模分布

### 第二节 中国华东地区半导体封装市场分析

#### 一、华东地区概述

#### 二、华东地区经济环境分析

#### 三、华东地区半导体封装市场规模分析

#### 四、华东地区半导体封装市场规模预测

### 第三节 华北地区市场分析

#### 一、华北地区概述

#### 二、华北地区经济环境分析

#### 三、华北地区半导体封装市场规模分析

#### 四、华北地区半导体封装市场规模预测

#### 第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区半导体封装市场规模分析
- 四、华南地区半导体封装市场规模预测

#### 第九章 2017-2020年中国半导体封装行业竞争情况

##### 第一节 中国半导体封装行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

##### 第二节 中国半导体封装行业SWOT分析

- 一、行业优势分析
- 二、行业劣势分析
- 三、行业机会分析
- 四、行业威胁分析

##### 第三节 中国半导体封装行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

#### 第十章 半导体封装行业企业分析（随数据更新有调整）

##### 第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

##### 第二节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

### 第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

### 第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

### 第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

### 第六节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

### 第七节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

### 第八节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

### 第九节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析



## 第十节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

## 第十一章 2021-2026年中国半导体封装行业发展前景分析与预测

### 第一节 中国半导体封装行业未来发展前景分析

- 一、半导体封装行业国内投资环境分析
- 二、中国半导体封装行业市场机会分析
- 三、中国半导体封装行业投资增速预测

### 第二节 中国半导体封装行业未来发展趋势预测

### 第三节 中国半导体封装行业市场发展预测

- 一、中国半导体封装行业市场规模预测
- 二、中国半导体封装行业市场规模增速预测
- 三、中国半导体封装行业产值规模预测
- 四、中国半导体封装行业产值增速预测
- 五、中国半导体封装行业供需情况预测

### 第四节 中国半导体封装行业盈利走势预测

- 一、中国半导体封装行业毛利润同比增速预测
- 二、中国半导体封装行业利润总额同比增速预测

## 第十二章 2021-2026年中国半导体封装行业投资机遇、风险与营销分析

### 第一节 半导体封装产业投资面临的机遇

- 一、政策机遇
- 二、技术创新机遇
- 三、市场机遇
- 四、其他机遇

### 第二节 半导体封装行业投资风险分析

- 一、半导体封装行业政策风险分析
- 二、半导体封装行业技术风险分析
- 三、半导体封装行业竞争风险
- 四、半导体封装行业其他风险分析

### 第三节 半导体封装行业企业经营发展分析及建议

- 一、半导体封装行业经营模式

二、半导体封装行业销售模式

三、半导体封装行业创新方向

第四节 半导体封装行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国半导体封装行业发展战略及规划建议

第一节 中国半导体封装行业品牌战略分析

一、半导体封装企业品牌的重要性

二、半导体封装企业实施品牌战略的意义

三、半导体封装企业品牌的现状分析

四、半导体封装企业的品牌战略

五、半导体封装品牌战略管理的策略

第二节 中国半导体封装行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国半导体封装行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国半导体封装行业发展策略及投资建议

第一节 中国半导体封装行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国半导体封装行业定价策略分析

### 第三节 中国半导体封装行业营销渠道策略

一、半导体封装行业渠道选择策略

二、半导体封装行业营销策略

### 第四节 中国半导体封装行业价格策略

### 第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国半导体封装行业重点投资区域分析

二、中国半导体封装行业重点投资产品分析

图表详见正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/516238516238.html>